



„Advanced Packaging und Systemintegration -“ Ein Markenzeichen der Hauptstadtregion Berlin



Einführung: **Prof. Dr. Hans Richter**,
Vorstandsvorsitzender, GFWW e. V., Frankfurt (Oder)

ergänzt durch **Mariusz Rzeznikiewicz**,
„Wertschöpfungsketten in der Mikroelektronik sind Länderübergreifend“



Peter Krause,
Geschäftsführer INSENSO GmbH, Berlin
und Prignitz Mikrosystemtechnik GmbH, Wittenberge,
Vorstandsvorsitzender
AMA Verband für Sensorik und Messtechnik e.V.



Lars Lust,
General Manager APAT Solutions
Swissbit Germany AG, Berlin



Mariusz Rzeznikiewicz,
Beauftragter BVMW, Frankfurt (Oder)

Chancen

- Neue Wege für Chip-Leistungssteigerung durch Advanced Packaging
- Hohes Wertschöpfungspotenzial für Design (bis zu 50 Prozent der gesamten Wertschöpfung)
- Mit der Forschungsfabrik Mikroelektronik ist Deutschland starker Technologiepartner
- Einbettung in das EU-Ökosystem (EU Chips Act und Chips Joint Undertaking)
- Stark wachsende Nachfrage nach Hochleistungschips aus den Segmenten KI und Rechenzentren
- Vertrauenswürdige Chip-Hardware entlang der gesamten Lieferkette von der Produktion bis zum Kunden sollte durchgehend sicher, nachvollziehbar und zuverlässig sein, z. B. durch innovative KI-Verfahren mit Privacy-by-Design
- Verlässliche internationale Technologiepartner, z. T. bereits vor Ort investiert
- Vielfältige Anwendungsfelder

**Hightech Agenda
Deutschland**

